## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61275352 A

(43) Date of publication of application: 05.12.86

(51) Int. CI

C08L 79/08 C08K 5/10

(21) Application number: 60116553

(22) Date of filing: 31.05.85

(71) Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

LTD

(72) Inventor:

**GOTO KOHEI** 

TAKINISHI FUMITAKA TOGO MAKIKO **IKEDA HIROHARU** 

#### (54) SOLUBLE POLYIMIDE SOLUTION

## (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a soluble polyimide soln. which is suitable for use in coating electronic parts and gives a coating film which is homogeneous, has excellent heat resistance, etc. and does not cause loss in tranparency by moisture absorption, by dissolving a soluble polyimide in a lactone-contg. solvent.

CONSTITUTION: A soluble polyimide is prepd., e.g., by

reacting a tetracarboxylic acid component (e.g. 2, 3, 5-tricarboxy cyclo pentyl acetic dianhydride) with a diamine (e.g. 4,4'-diaminodiphenyl ether) or a diisocyanate (e.g. 2,4-tolylene diisocyanate). The soluble polyimide is dissolved in a solvent contg. a lactone (e.g. γ-butyrolactone or γ-valerolactone) and pref. further an amide (e.g. N- methyl-2-pyrrolidone or N,N-dimethylacetamide) to obtain the desired soluble polyimide soln.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

## 19日本国特許庁(IP)

# ⑪特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-275352

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)12月5日

C 08 L C 08 K 79/08 5/10

CAM

2102 - 4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

③発明の名称

可溶性ポリイミド溶液

願 昭60-116553 到特

②出 願 昭60(1985)5月31日

79発 明者 後 藤 峷 平

貴

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

内

⑫発 明 者 淹 西 文 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

内

②発 明 者 東郷 真 紀 子 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

内

明 ⑦発 者 池 田 弘 治 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

内

⑦出 顖 人 日本合成ゴム株式会社

邳代 理 人 弁理士 白井 重隆 東京都中央区築地2丁目11番24号

#### 細

1. 発明の名称

可溶性ポリイミド溶液

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 可溶性ポリイミドをラクトン類を含有してな る溶媒に溶解してなる可溶性ポリイミド溶液。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ポリイミドの溶液に関し、特に電子 部品用コーティング材料としての可溶性ポリイミ ドを特定の有機溶剤に溶解させた溶液に関する。

従来の技術

従来、電子部品、例えばIC、トランジスター、 磁気ヘッドなどの層間絶縁膜、太陽電池の絶縁膜、 ならびに各種素子の保護膜、α線遮蔽膜および液 晶配向膜としてポリイミドが用いられており、中 でも可溶性ポリイミドは、ポリイミドの前駆体で あるポリアミック酸化合物を硬化して得られるポ リイミドに比べ、溶液とした場合に優れた保存安 定性を有し、イミド化のための高温での長時間に

よる処理が不必要であることなどの理由により多 用されつつある。

発明が解決しようとする問題点

前記の可溶性ポリイミドの薄膜を形成させる場 合、通常、溶液として基体に塗布した後に乾燥さ せて形成させるが、この際に用いる溶媒としては 一般的にN-メチルー2-ピロリドン、N. N-ジメチルアセトアミドなどのアミド系溶媒が用い られており、これらの溶媒は吸湿性が高く、また 吸湿した溶液で基体にコーティングを行うと、コ ーティング膜が失透する問題を発生する。

更に、比較的均質な薄膜を形成できるスピンナ ーを用いたコーティング法でアミド系溶媒による 可溶性ポリイミド溶液のコーティングを行った場 合にも、塗膜に斑点やストリエーションが発生し 均質な塗膜が得られにくく、スピンナーの回転数 を上げたり、コーティングに長時間を要するなど の問題を有していた。

本発明の目的は、かかる従来の技術的課題を解 決し、可溶性ポリイミドと特定の有機溶剤からな る均質性や堕布性の優れた可溶性ポリイミド溶液 を提供することにある。

問題点を解決するための手段

即ち本発明は、可溶性ポリイミドをラクトン類を含有してなる溶媒に溶解してなる可溶性ポリイミド溶液を提供するものである。

本発明で用いることのできる可溶性ポリイミドとしては、本発明の特定の有機溶剤系に溶解しうるものであれば特に制限はなく、例えば下記テトラカルボン酸成分(A)と下記ジアミン(B)またはジイソシアネート(C)とを反応させることにより得られるポリイミドの構造を有するポリイミドを挙げることができる。

かかるテトラカルボン酸成分(A)としては、
ブタンテトラカルボン酸、1,2,3,4-シ
ロプタンテトラカルボン酸、1,2,3,4-シ
クロペンタンテトラカルボン酸、2,3,5-ト
リカルボキシシクロペンチル酢酸、3,5,6トリカルボキシーノルボルナン-2-酢酸、5(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-

# 来る。

また、前記テトラカルボン酸成分 (A) と反応 させる一般的なジアミン (B) またはイソシアネ -ト (C) としては、一般式:

H. N-R-NH. または一般式:

OCN-R-NCOで示される化合物(Rは、2 価の芳香族基、脂肪族基、脂環族基、オルガノシロキサン基などの有機基を示す)である。

前記一般式における好ましいRとしては、例えば、

$$-\bigotimes_{X_{2}}^{X_{1}}-\bigvee_{X_{3}}^{X_{3}}-(Y_{0})n-\bigotimes_{X_{4}}^{X_{3}}$$

(式中、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>3</sub>およびX<sub>4</sub>は、同一 でも異なってもよく、-H、-CH<sub>3</sub>または -OCH<sub>3</sub>、Y<sub>6</sub>は-CH<sub>4</sub>-、-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-、

メチルーシクロヘキセンジカルボン酸、ピシクロ (2, 2, 2) - オクト- 7 - エンーテトラカル ボン酸、1, 2, 3, 4-フランテトラカルボン 酸、4,4'-ピス(3,4-ジカルポキシフェ ノキシ) ジフェニルスルフィド、4, 4′ーピス (3, 4-ジカルポキシフェノキシ) ジフェニル スルホン、4. 4′-ピス(3. 4-ジカルボキ シフェノキシ) ジフェニルプロパン、3.3′. 4, 4 '-パーフルオロイソプロピリデンテトラ カルポン酸、3、3′、4、4′-ピフェニルエ ーテルテトラカルポン酸、ピス(フタール酸)フ ェニルホスフィンオキサイド、p-フェニレンー ピス-(トリフェニルフタール酸)、m-フェニ レンーピスー(トリフェニルフタール酸)、ピス (トリフェニルフタール酸) - 4, 4′ージフェ ニルエーテル、ピス(トリフェニルフタール酸) - 4 , 4 ' - ジフェニルメタンなどのテトラカル ポン酸類の無水物を用いた可溶性ポリイミドを挙 げることが出来る。

これらは単独もしくは混合して用いることが出

- C O N H - を示し、n は 0 または 1 を示す。) で示される芳香族基、- (C H<sub>2</sub>) n -(式中、n は 2 ~ 2 0 の整数を示す。)、

で示される。炭素数2~20の脂肪族基または脂環族基、

$$-R'-Si \qquad O-Si \qquad R'$$

(式中、R'は - (L=1~50)、

などの2価の脂肪族基、脂環族基または芳香族基を示し、R \* は、



Cn H<sub>2n-1</sub>— (式中、nは1~20の整数を示す。) などの1価の脂肪族、脂環式または芳香族の炭化 水素基を示し、mは1~100の整数である。〕 で示されるオルガノシロキサン基を挙げることが できる。

前記ジアミン (B) の具体例としては、、パラフェニレンジアミン、メタフェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエタン、ベンジジン、4,

4′-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4′ ージアミノジフェニルスルホン、4. 4′ージア ミノジフェニルエーテル、1.5-ジアミノナフ タレン、3、3′-ジメチル-4、4′-ジアミ ノビフェニル、3, 4′-ジアミノベンズアニリ ド、3, 4′-ジアミノジフェニルエーテル、3, 3 ' - ジアミノベンゾフェノン、3. 4 ' - ジア ミノベンゾフェノン、4,4′-ジアミノベンゾ フェノン、メタキシリレンジアミン、1.3-プ ロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペン タメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、 ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミ ン、ノナメチレンジアミン、4,41-ジメチル ヘプダメチレンジアミン、1, 4-ジアミノシク ロヘキサン、イソホロンジアミン、テトラヒドロ ジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキサヒド ロー4、1~メタノインダニレンジメチレンジア ミン、トリシクロ (6, 2, 1, 0\*\*\*) - ウン デシレンジメチルジアミンおよび

などで示されるジアミノボルガノシロキサンを挙 げることができる。

これらのジアミンは、1種単独でも2種以上の 組み合わせでも使用することができる。

また、前記ジイソシアネート(C)の具体例と しては、2, 4-トリレンジイソシアネート、2, 6-トリレンジイソシアネート、p-フェニレン ジイソシアネート、m-フェニレンジイソシアネ - ト 、 4 . . 4 ′ -ジフェニルメタンジイソシアネ ート、4,4'ージフェニルエーテルジイソシア ネート、4、4′ージフェニルスルホンジイソシ アネート、4, 4′-ジフェニルスルフィドジイ ソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネ ート、2,6ーナフタレンジイソシアネート、ト リジンイソシアネート、4,41-ピフェニルジ イソシアネート、p-キシリレンジイソシアネー ト、m-キシリレンジイソシアネートなどの芳香 族ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネー ト、1、3-ピス(イソシアネートメチル)シク ロヘキサン、1、4-ピス(イソシアネートメチ ル) シクロヘキサン、4、4′-ジシクロヘキシ ルメタンジイソシアネート、4, 4′ージシクロ ヘキシルエーテルジイソシアネートなどの脂環族 ジイソシアネート、アタンジイソシアネート、ヘ

キサメチレンジイソシアネート、オクタメチレン ジイソシアネート、リジンジイソシアネート、ト リメチルヘキサメチレンジイソシアネートなどの 脂肪族ジイソシアネートを挙げることができる。

これらのジイソシアネートは、単独または混合 して用いることができる。

また、他の可溶性ポリイミドとしては、下記チトラカルポン酸成分(D)と下記ジアミン(E)とを反応させることにより得られるポリイミドの構造を有するポリイミドを挙げることができる。

かかるテトラカルボン酸成分(D)としては、 前記テトラカルボン酸成分(A)以外にピロメリ ット酸、3,3',4,4'ーペンゾフェノンテ トラカルボン酸、3,3',4,4'ーピフェニ ルスルホンテトラカルボン酸、1,4,5,8ー ナフタレンテトラカルボン酸、2,3,6,7ー ナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4,4' ーピフェニルエーテルテトラカルボン酸、3,3',4 4,4'ージメチルジフェニルシランテトラカル ボン酸、3,3',4,4'ーテトラフェニルシ

これらテトラカルボン酸成分 (D) またはジアミン (E) は、単独または 2 種以上混合して用いることができる。

本発明に使用される可溶性ポリイミドの最も好ましい例は、下記一般式 (I) で示される繰り返し構造単位を有するポリイミドである。

(式中、Rは前記に同じ)

本発明に用いられる可溶性ポリイミドの固有粘度 ( n inh = l n n ret / c、c = 0 . 5 g / d 、3 0 で、ジメチルホルムアミド中)は、好ましくは 0 . 0 5 は 0 . 0 5 d / g であり、特に射ましくは 0 . 0 5 ~ 5 d / g であり、特に前配一般式で示される繰り返し単位が好ましくは 5 0 重量%以上、特に好ましくは 7 5 重量%以上有する可溶性ポリイミドが好適である。

これら本発明の可溶性ポリイミドは、例えばテ

ランテトラカルボン酸などのテトラカルボン酸類 の無水物を挙げることができる。

前記テトラカルボン酸成分(D)と反応させる ジアミン成分 (E) としては、ピス (4-アミノ フェニル) フルオレン、ジアミノテトラフェニル チオフェン、4,4′-フタリド-3,3′-ジ アミノジフェニルエーテル、4, 4′-フタリド 3、3′-ジアミノジフェニルメタン、4、4′ - フタリド - 3 、3 ′ ジアミノベンゾフェノン、 4, 4 '-アセトアミドー3, 3 ' - ジアミノジ フェニルエーテル、4, 4'-アセトアミドー3, 3′-ジアミノジフェニルメタン、4.4′-ア セトアミドー3、3′ージアミノベンゾフェノン、 4-スルホンアミドー1、3-フェニレンジアミ ン、4,6-ピス(アミノフェニル)-1,3-フェニレンジアミン、5-アミノ-1 (4'-ア ミノフェニル) -1, 3, 3-トリメチルインダ ン、6-アミノー1 (4'-アミノフェニル) -1,3,3-トリメチルインダンなどを挙げるこ とができる。

トラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応から 得られるポリアミック酸を経由して製造する場合 は、ポリアミック酸を加熱脱水することによるイ ミド化反応を行うか、あるいは酸無水物共存下な どの一般的に公知の化学的イミド化反応を行うこ とにより製造することができる。

また、テトラカルボン酸二無水物とジイソシアネートとを反応させ可溶性ポリイミドを製造する場合には、トリエチルアミン、ピリジン、ピコリン、キノリン、イソキノリン、トリエチレンジアミン、1.8-ジアザピシクロ(5,4,0)-7-ウンデセンなどの塩基性化合物を触媒に用い、加熱反応させることによって製造することができる。

なお、前記一般式 (I) で示される繰り返し構 造単位を有する本発明に好ましく用いられる可溶 性ポリイミドは、例えば

①2、3、5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物とジアミンとから得られるボリアミック酸を有機溶媒溶液とし、有機カルボン酸無水物

の存在下にイミド化反応させるか (特開昭 5 9 - 1 9 9 7 2 0 号公報) 、

② 2 . 3 . 5 - トリカルボキシシクロペンチル酢 酸二無水物とジイソシアネートを有機溶媒中で反 応させる (特開昭 6 0 - 1 2 1 8 号公報) ことに よって製造される。

ここで 2、3、5 - トリカルボキシシクロペンチル酢酸(以下「TCA」という)は、例えばジシクロペンタジエンをオゾン分解し、過酸化水素で酸化する方法(英国特許第872355号明細書、J. Org. Chem.、28、2537(1963)またはジシクロペンタジエンを和して得られるヒドロキシジシクロペンタジエンを明細書)などによって製造することができ、このTCAを脱水することにより2、3、5 - トリカルボキシンクロペンチル酢酸二無水物(以下「TCA・AH」という)を製造することができる。

以上のポリイミドの製造における反応系に用い

ブチロラクトン、 r. r - ジメチルブチロラクト ンなどを挙げることができ、好ましいラクトン類 は炭素数が 3 ~ 6 のラクトン類である。

また、本発明の可溶性ポリイミド溶液には、アミド類からなる溶媒を併用することが好ましく、アミド類としては N ーメチルー 2 ーピロリドン、N・Nージメチルアセトアミド、N・リアミド、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミド、ホルムアミド、Nーメチルアミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、2 ーピロリドンなどを挙げることができる。

アミド類を併用する場合の溶媒中のラクトン類の組成は、5~95重量部、好ましくは10~90重量部であり、アミド類の組成は、5~95 重量部、好ましくは10~90重量部である。

ラクトン類の組成が5重量部未満では該溶媒が吸水すると塗膜の失透を防止できず、一方95重量部を超えるとスピンナーで塗膜形成時の塗膜状態の表面均一性を保つのが困難となる。

ることのできる有機溶媒としては、前記ポリアミック酸や可溶性ポリイミドを溶解させるものであれば特に制限はなく、例えばN-メチル-2-ピロリドン、N・ツメチルアセトアミド、ハージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキントリアミドなどの非プロ・トッスチャン系極性溶媒、m-クレゾール、キシレノール、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェノール系溶媒を挙げることができる。

また、可溶性ポリイミドのうち、特に溶解性の 優れた系においては、ハロゲン化炭化水素やエー テル系溶媒なども用いることができる。.

本発明の可溶性ポリイミド溶液は、かかる可溶性ポリイミドにラクトン類を含有してなる溶媒に溶解したものである。

ここで、ラクトン類としては、 r - プチロラクトン、 r - パレロラクトン、 r - カプロラクトン、 δ - クロロー r - パレロラクトン、 δ - クロロー r - パレロラクトン、 α - ジメチル

本発明の可溶性ポリイミド溶液は、通常、可溶性ポリイミド濃度0.1~30重量%、好ましくは0.1~20重量%の濃度に調製される。

なお、本発明の可溶性ポリイミド溶液は、前記 特定の溶媒の他にその他の一般的有機溶媒である アルコール類、フェノール類、ケトン類、エステ ル類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化 水素類、例えばメチルアルコール、エチルアルコ ール、イソプロピルアルコール、エチレングリコ ール、プロピレングリコール、1, 4ープタンジ オール、トリエチレングリコール、エチレングリ コールモノメチルエーテル、フェノール、m-ク レゾール、アセトン、メチルエチルケトン、メチ ルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メ チル、酢酸エチル、酢酸プチル、蓚酸ジエチル、 マロン酸ジエチル、ジエチルエーテル、エチレン グリコールメチルエーテル、エチレングリコール エチルエーテル、エチレングリコールnープロピ ルエーテル、エチレングリコールisoープロピ ルエーテル、エチレングリコールn-ブチルエー

このようにして調製される本発明の可溶性ポリイミド溶液は、基材にロールコーター法、スピンナー法、印刷法などで塗布し、次いで例えば80~250℃、5~180分乾燥することによって可溶性ポリイミドの塗膜を形成することができる。

#### 実施例

以下、実施例を挙げ本発明を更に具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。

参考例1

#### 一晩乾燥した。

得られた可溶性ポリイミドのDMF中、30℃ の粘度 ninh は、0.79 dt/gであった。

この可溶性ポリイミドを再度DMFに溶解し、 ガラス板上に流延し乾燥した後、フィルムを剝離 し赤外線吸収スペクトルを測定した結果、

1740 cm<sup>-1</sup>および1690 cm<sup>-1</sup>にイミドの C=0 伸縮振動に基づく吸収が認められた。

これにより、無水酢酸とピリジンの存在下でポリアミック酸溶液を加熱反応させることにより、 可溶性ポリイミドが得られることが分かる。

#### 参考例 2

窒素雰囲気下でTCA・AH22. 4gおよび4.4′ージフェニルメタンジイソシアネート25.0gをメタクレソール200mℓに溶解させた。次に触媒としてトリエチルアミン4gを加えて180~190℃に昇温し、7時間反応させた。この反応溶液を大量のアセトンと混合しポリィミドを凝固折出し、乾燥することにより38gのポリイミド粉末を得た。

ジアミノジフェニルエーテル (DDE)
20.48g(0.102モル)を、N.Nージメチルホルムアミド (DMF) 247.5gに溶解した後、2,3.5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 (TCA・AH) 23.15g(0.103モル)を粉末のまま加えて攪拌しながら25で反応させた。24時間後にこの反応を少量サンプリングし、ボリアミック酸が0.5g/100mlの濃度になるようにDMFを加えて固有粘度(30で)を測定した。

得られたポリアミック酸の $\eta_{inh}$  は0.99d /gであった。

次いで、前記反応液に更にDMFを加えてポリアミック酸濃度を6. 1 重量%とした溶液30gを100m2のフラスコに移し、この溶液に無水酢酸1. 32gおよびピリジン1.02gを順次加えて混合、攪拌した後、135℃で2時間反応させた。

次いで反応生成物を大量のメタノールに注いで 可溶性ポリイミドを凝固し回収した後、80℃で

得られた可溶性ポリイミドの固有粘度(マ゙inh)は、0.99 dd/gであった。この可溶性ポリイミドを再度DMFに溶解し、ガラス板上に流延し乾燥した後、フィルムを剝離し赤外線吸収スペクトルを測定した結果、1710 cm<sup>-1</sup>、1780 cm<sup>-1</sup>および1370 cm<sup>-1</sup>にイミドのC=0伸縮振動に基づく吸収が認められた。

# 参考例 3

テトラカルボン酸成分としてTCA・AH/3,3′,4,4′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸=75/25(モル比)とした以外は、参考例1と同様にして反応させ、固有粘度(πink)が、0.7641/gの可溶性ポリイミドを得た。

#### 参考例 4

ジアミン成分として4. 4'ージアミノジフェニルエーテル/(3ーアミノプロピル)テトラメチルジシロキサン=90/10(モル比)とした以外は、参考例1と同様にして反応させ、固有粘度(7ink)が、0.6841/gの可溶性ポリイミドを得た。

#### 実施例1

参考例1で得られた可溶性ポリイミドをェーブ チロラクトン/N、Nージメチルアセトアミドロ 80/20 (重量比) からなる混合溶媒を用いて 5 重量%のポリイミド溶液を調製した。

得られた溶液を孔径 0. 2 2 μmのメンブランフィルターで濾過し、不溶分を除去した。

この溶液をガラス基板上にスピンナーを用いて 2.000rpm、60秒の条件で鹽布したとこ ろ、基板上にはじきもなく均一に塗布することが できた。

塗布後、150℃で1時間クリーンオーブン中で乾燥させた。乾燥後のポリイミド塗膜は、干渉 縞、斑点、ストリエーションもなく、均一であった。

## 比較例1

実施例1で用いた混合溶媒系の代わりにN, N - ジメチルアセトアミドを用い、実施例1と同様 にスピンコーティング、乾燥を行った。

得られた塗膜は、失透した斑点が多く、不均一

ラス基板周辺に斑点が観察され、均一な塗膜とは いえなかった。

### 実施例 4

実施例5

実施例 3 で用いた混合溶媒系の代わりに r ープチロラクトンを用い、実施例 1 と同様にスピンコーティング (ただし条件は、3.000 r p m、3分)、乾燥を行った。得られた塗膜は、透明であり、かつストリエーションもなく均一であった。

実施例3で用いたポリイミド溶液にポリイミドの濃度が0.5重量%となるように水を加えた。

この溶液を用いて実施例1と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた塗膜は、透明であり、かつ干渉縞、斑点、ストリエーションもなく均一であった。

### 実施例 6

実施例1で用いた混合溶媒の組成を r ープチロラクトン/N、N ージメチルホルムアミド = 60 / 40 (重量比) に代え、実施例1と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた塗膜は、

なものであった。

### 実施例 2

実施例1で用いた混合溶媒系の代わりに r ープチロラクトンを用い、実施例1と同様にスピンコーティング (ただし条件は、3.000 r p m、3分)、乾燥を行った。得られた塗膜は、透明であり、かつストリエーションもなく均一であった。

#### 実施例3

実施例1で用いた混合溶媒の組成を r ープチロラクトン/N、N ージメチルアセトアミド=20/80(重量比)に代え、更にポリイミドの濃度を 0.5 重量%にして、実施例1と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた塗膜は、透明であり、かつ干渉縞、斑点、ストリエーションもなく均一であった。

## 比較例 2

実施例3で用いた混合溶媒系の代わりにN、N - ジメチルアセトアミドを用い、実施例1と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた 塗膜は、比較例1とは異なり透明であったが、ガ

透明であり、かつ干渉縞、斑点、ストリエーションもなく均一であった。

## 比較例3

実施例 6 で用いた混合溶媒系の代わりに N. N - ジメチルホルムアミドを用い、実施例 1 と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた 徳膜は、不透明なものであった。

## 実施例7

実施例1で用いた混合溶媒の組成を r ープチロラクトン/ N ーメチルー 2 ーピロリドン= 4 0 / 6 0 (重量比) に代え、実施例1 と同様にスピンコーティング、乾燥を行った。得られた塗膜は、透明で均一なものであった。

#### 実施例8

実施例7で用いたポリイミド溶液に水を加え、 該溶液の濃度を0.5重量%にして、実施例7と 同様にスピンコーティング、乾燥を行った。

得られた塗膜は、失透もなく、透明で均一であった。

## 実施例9

参考例 2 で得られた可溶性ポリイミドを r - ブ チロラクトン/ N , N - ジメチルアセトアミド = 5 0 / 5 0 (重量比) からなる混合溶媒を用いて 3 重量 % のポリイミド溶液を調製した。

得られた溶液を孔径 0.22μmのメンブランフィルターで濾過し、不溶分を除去した。

この溶液をガラス基板上にスピンナーを用いて 2,000rpm、60秒の条件で塗布したとこ ろ、基板上にはじきもなく均一に塗布できた。

塗布後、150℃で1時間クリーンオープン中で乾燥させた。乾燥後のポリイミド塗膜は、干渉 縞、斑点、ストリエーションもなく、均一であった。

## 比較例 4

実施例 9 で用いた混合溶媒系の代わりにN.N ージメチルアセトアミドを用い、実施例 9 と同様 にスピンコーティング、乾燥を行った。

得られた**塗膜は、不透明の斑点が多く現れて不** 均一なものであった。

#### 実施例10

参考例 4 で得られたポリイミドを r ープチロラクトン/N、N ージメチルアセトアミド = 4 0 / 6 0 (重量比) からなる混合溶媒を用いて 3 重量 %のポリイミド溶液を調製した。

得られた溶液を孔径 0. 2 2 μ m のメンプランフィルターで濾過し、不溶分を除去した。

この溶液をガラス基板上にスピンナーを用いて 2,000rpm、60秒の条件で塗布したとこ ろ、基板上にはじきもなく均一に塗布できた。

塗布後、150℃で1時間クリーンオーブン中で乾燥させた。乾燥後のポリイミド塗膜は、干渉 縞、斑点、ストリエーションもなく、均一であった。

## 比較例6

実施例11で用いた混合溶媒系の代わりにN, N-ジメチルホルムアミドを用い、実施例10と 同様にスピンコーティング、乾燥を行った。

得られた塗膜は、不透明の斑点が現れて不均一 なものであった。 参考例 3 で得られたポリイミドを r ープチロラクトン/ N , N ージメチルアセトアミド = 4 0 / 6 0 (重量比) からなる混合溶媒を用いて 1 重量%のポリイミド溶液を調製した。

得られた溶液を孔径 0. 2 2 μmのメンブランフィルターで濾過し、不溶分を除去した。

この溶液をガラス基板上にスピンナーを用いて 2,000rpm、60秒の条件で塗布したとこ ろ、基板上にはじきもなく均一に塗布できた。

塗布後、150℃で1時間クリーンオーブン中で乾燥させた。乾燥後のポリイミド塗膜は、干渉 縞、斑点、ストリエーションもなく、均一であった。

#### 比較例 5

実施例10で用いた混合溶媒系の代わりにN. N-ジメチルアセトアミドを用い、実施例10と 同様にスピンコーティング、乾燥を行った。

得られた塗膜は、不透明の斑点が現れて不均一 なものであった。

#### 実施例11

## 発明の効果

本発明によれば、可溶性ポリイミドと特定の有機溶媒からなる溶液は、吸湿しても塗膜の失透がなく、スピンコーティングによる塗膜表面も斑点、ストリエーションなどもなく、均一な塗膜を形成することができる。

従って本発明の可溶性ポリイミ溶液は、耐熱性、機械的性質、電気的性質、耐薬品性などに優れ、電子産業部門において例えばΙC、トランジスター、磁気へッドなどの層間絶縁膜、太陽電池の絶縁膜、ならびに各種素子の保護膜、α線遮蔽膜および液晶配向膜に好適に用いることができ、例えばポリエステルなどの有機高分子材料、ガラスシリコンウェハー、ITO透明電極のコーティング用素材として特に優れた性能を発揮するものである。

特許出願人 日本合成ゴム株式会社 代理人 弁理士 白 井 重 隆